PRESSEINFORMATION

HybridPACK™ Drive G2 Fusion: Infineon kombiniert Silizium und Siliziumkarbid in einem neuartigen Leistungsmodul für die E-Mobilität

München, Deutschland – 15. Oktober 2024 – Um Elektromobilität einem breiteren Markt zugänglich zu machen, ist eine Kombination aus hoher Leistung und Effizienz zu vergleichsweisen geringen Kosten entscheidend. Genau aus diesem Grund bringt die Infineon Technologies AG das HybridPACK™ Drive G2 Fusion auf den Markt und setzt damit einen neuen Standard für Leistungsmodule für Traktionsumrichter in der Elektromobilität. Das HybridPACK Drive G2 Fusion ist das erste Plug-and-Play-Leistungsmodul, das die Silizium- und Siliziumkarbid (SiC)-Technologien von Infineon kombiniert. Mit dieser innovativen Lösung wird ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosteneffizienz erreicht, das neue Möglichkeiten für die Optimierung von Umrichtern eröffnet.

Der Hauptunterschied zwischen Silizium und SiC in Leistungsmodulen besteht darin, dass SiC eine höhere Wärmeleitfähigkeit, Durchbruchspannung und Schaltgeschwindigkeit aufweist, wodurch die Bauteile effizienter, aber auch teurer als siliziumbasierte Leistungsmodule sind. Mit dem neuen Modul kann jedoch der SiC-Anteil pro Fahrzeug bei gleicher Leistung und Effizienz des Fahrzeugs und geringeren Systemkosten reduziert werden. So können Systemlieferanten beispielsweise mit nur 30 Prozent SiC und 70 Prozent Silizium nahezu die Systemeffizienz einer kompletten SiC-Lösung erreichen.

„Unser neues HybridPACK Drive G2 Fusion-Modul unterstreicht die führende Position von Infineon bei Innovationen in der Automotive-Halbleiter-Industrie“, sagte Negar Soufi-Amlashi, Senior Vice President & General Manager High Voltage der Automotive Division von Infineon. „Mit diesem technologischen Durchbruch wird die Nachfrage nach einer größeren Reichweite in der E-Mobilität bedient, indem Siliziumkarbid und Silizium auf intelligente Weise kombiniert werden. Das Modul ist in ein bewährtes Modulgehäuse integriert und bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu reinen Siliziumkarbid-Modulen, ohne die Systemkomplexität für Automobilzulieferer und Fahrzeughersteller zu erhöhen.“

Das HybridPACK Drive G2 Fusion-Modul erweitert das Portfolio der HybridPACK Drive-Leistungsmodule von Infineon. Es kann schnell und einfach in Fahrzeugkomponenten oder -module integriert werden, ohne dass komplexe Anpassungen oder Konfigurationen

Public / Für die Wirtschafts- und Fachpresse
Informationsnummer: INFATV202410-010d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
+49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com

erforderlich sind. Das HybridPACK Drive G2 Fusion-Modul liefert bis zu 220 kW in der 750-V-Klasse. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit über den gesamten Temperaturbereich von -40 °C bis +175 °C sowie eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit. Die besonderen Eigenschaften der CoolSiC™-Technologie sowie der Silizium-IGBT-EDT3-Technologie von Infineon mit sehr schneller Einschaltzeit ermöglichen sowohl den Einsatz eines Single-Gate-Treibers als auch eines Dual-Gate-Treibers. Dadurch ist eine einfache Umgestaltung von Silizium- oder SiC-Umrichtern zu Fusionsumrichtern möglich. Prinzipiell ermöglicht die ganzheitliche Expertise von Infineon in den Bereichen der SiC-MOSFET- und Silizium-IGBT-Technologie, der Leistungsmodul-Gehäuse, Gate-Treiber und Sensorik hochwertige Premium-Produkte, die Kosteneinsparungen auf Systemebene ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist die Integration von Swoboda- oder XENSIV-Hall-Sensoren in das HybridPACK-Drive-Gehäuse, wodurch eine präzisere und effizientere Motorsteuerung erreicht wird.

Infineon wird den neuen HybridPACK Drive G2 Fusion auf der electronica 2024 in München vom 12. bis 15. November (Halle C3, Stand 502) vorstellen.

Infineon auf der electronica 2024

Auf der diesjährigen electronica in München präsentiert Infineon innovative Lösungen für Anwendungen, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellen. Halbleiter tragen auf vielfältige Weise zur umweltfreundlichen und digitalen Transformation bei und helfen, eine vollelektrische Gesellschaft zu gestalten. Auf der electronica 2024 bietet Infineon die Möglichkeit, nachhaltige Technologien zu erkunden, die die Mobilitäts- und Automobilbranche revolutionieren, nachhaltige Gebäude und ein intelligenteres Leben ermöglichen und das Wachstum der künstlichen Intelligenz mit minimalen ökologischen Auswirkungen fördern. Unter dem Motto „Driving Decarbonization and Digitalization. Together." präsentiert das Unternehmen vom 12. bis 15. November in Halle C3, Stand 502 intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/electronica

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY" notiert. Infineon wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year 2024" ausgezeichnet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com
Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Public / Für die Wirtschafts- und Fachpresse
Informationsnummer: INFATV202410-010d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
+49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Public / Für die Wirtschafts- und Fachpresse
Informationsnummer: INFATV202410-010d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
+49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com